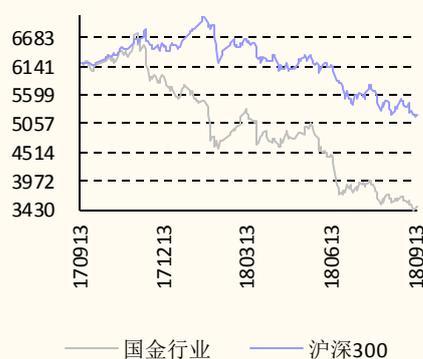


市场数据(人民币)

市场优化平均市盈率	18.90
国金器件指数	3472.99
沪深300指数	3236.57
上证指数	2686.58
深证成指	8163.76
中小板综指	8352.74



相关报告

- 1.《思源电气转战存储器领域，台积电双董再论半导体产业趋势-【半导...】》，2018.9.6
- 2.《半导体行业 2018 上半年大盘点，封测领域有人欢喜有人愁-【半...】》，2018.8.30
- 3.《比特大陆芯片新增视频功能，可重构芯片架构引领物联网时代-【半...】》，2018.8.23
- 4.《韦尔股份将成中国传感器霸主，闪存行业新架构出炉-【半导体周报...】》，2018.8.16
- 5.《半导体清洗设备新星财报抢眼，台积电首次遭遇安全危机-【半导体...】》，2018.8.10

樊志远 分析师 SAC 执业编号: S1130518070003
(8621)61038318
fanzhiyuan@gjzq.com.cn

宋敬祎 联系人
songjingyi@gjzq.com.cn

范彬泰 联系人
fanbintai@gjzq.com.cn

麒麟 980 芯片提升华为手机销售动能，国内封测大厂纷纷布局 5G 时代

本周重点

- 华为首款 7nm 芯片将为下半年手机销量注入强心剂
- 长电科技：封测龙头备战 5G 通讯和物联网
- 华天科技拟与控股股东收购马来西亚封装厂 Unisem75%股份

核心观点

- 华为海思半导体最新发布的这款麒麟 980 芯片采用了台积电最先进的 7nm 工艺，让海思麒麟芯片再一次成为了安卓世界的最强者。此次推出的新一代麒麟 980AI 芯片预计将搭载 10 月 16 日发布的 mate20 和 mate 20 PRO 等旗舰机型首发，这两款手机也将成为安卓世界搭载 7nm 芯片的唯一旗舰机型。原因在于台积电今年下半年的产能几乎被苹果和华为垄断，所以其他安卓手机搭载高通骁龙和联发科 7nm 芯片的机型最早也要在今年年底或明年一季度才会推出，因此最先推出 7nm 芯片的华为手机有望在今年下半年迎来新的出货量增长高峰期，华为手机的供应链企业将深度受益。
- 长电科技历时长达一年的定增预案终于落下帷幕，2018 年 9 月 1 日公司宣布向国家产业基金，芯电半导体和金投领航 3 名特定投资者增发约 2.4 亿股普通股，发行价格为 14.89 元/股，募集资金总额约为 36 亿元。此次募投项目之一是扩充先进封装技术的产能，形成 Bumping、WLCSP 等通讯与物联网集成电路中道封装年产 82 万片 Bumping、47 亿颗芯片封装的生产能力，把握先进封装行业的增长机会。其次公司也计划形成 Bumping、WLCSP 等通讯与物联网集成电路中道封装年产 82 万片 Bumping、47 亿颗芯片封装的生产能力，为即将到来的 5G 通讯和物联网发展机遇提前布局，此外为了缓解公司债务压力，降低经营风险，部分募集资金也会用于补充公司的流动性。
- 华天科技与控股股东华天电子集团拟以自愿全面要约方式联合收购 Unisem 公司 75.72%股份，收购对价 29.9 亿元。若交易完成后，公司营收有望破百亿，稳居世界前五大封装厂，预计公司营收与归母净利润均有 30%以上增长。同时可以扩大下游客户属性与应用范围，增加先进封装能力。Unisem 公司主要客户，包括 Broadcom、Qorvo、Skyworks 等公司。公司若交易完成后，可以增加对通信射频器件封装能力，填补在高端产品客户空白。在 5G 即将到来的关键时间点，公司有望直接受益。被收购标的注册于马来西亚，鉴于目前中美贸易战愈演愈烈，公司通过控股国外公司的行为，可以缓解中美贸易战增加关税对于公司产品的影响。

投资建议

- 建议关注：华为，台积电，苹果，高通和华天科技

风险提示

- 目前消费需求乏力，手机换机动力不足，华为手机出货量不及预期
- 苹果先于华为推出采用 7nm 工艺的新款机型，对于华为旗舰机型销售有可能造成冲击。
- 半导体行业景气度下降，对于封测行业营收造成不利影响。

内容目录

一、行业观察	3
【事件一】华为首款 7nm 芯片将为下半年手机销量注入强心剂	3
【事件二】长电科技：封测龙头备战 5G 通讯和物联网	6
【事件三】华天科技拟与控股股东收购马来西亚封装厂 Unisem75%股份	8
二、行情回顾	9
三、A 股重要公告总结	10
四、半导体行业公司限售股份解禁情况	11
五、半导体产业重点公司估值数据跟踪	12

图表目录

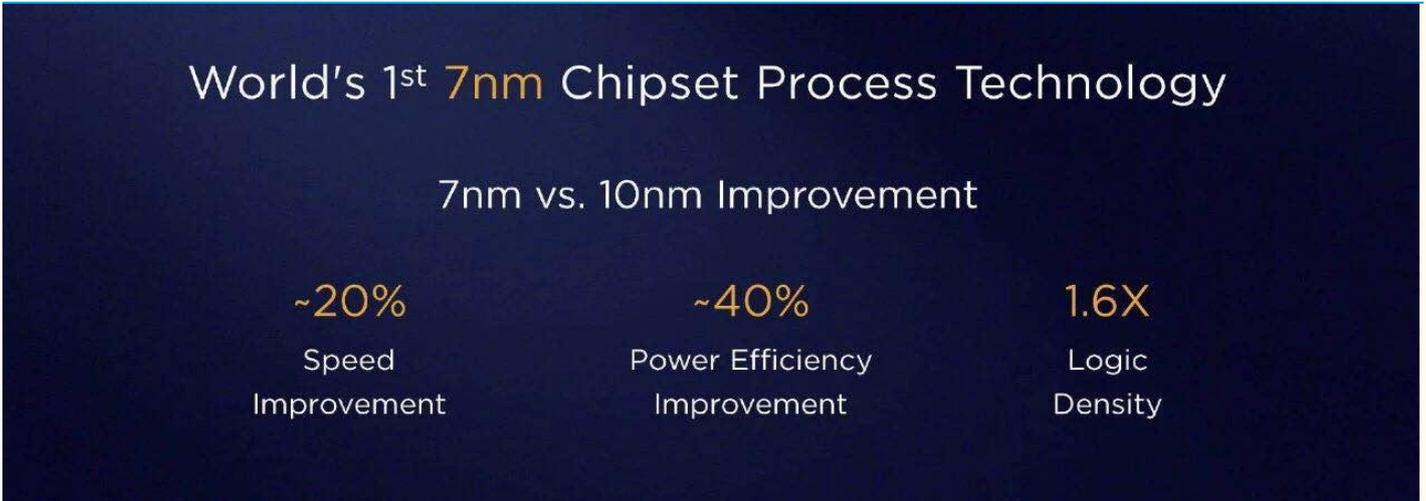
图表 1：麒麟 980 芯片提升方面汇总	3
图表 2：海思麒麟系列芯片“进化”之路	4
图表 3：华为海思，苹果和高通 7nm 手机芯片对比	4
图表 4：2015-2019E 华为手机出货量及麒麟芯片发布时间对比	5
图表 5：公司前五大股东定增前后的持股比例变化	6
图表 6：不同先进封装技术平台营收占比（十亿美元）	6
图表 7：2017 年先进封装市场各企业出货量占比	6
图表 8：1H18 国内封测企业净债务和带息负债率对比	7
图表 9：1H18 国内封测企业权益乘数和流动比率对比	7
图表 10：unisem 资产负债表（单位百万元）	8
图表 11：Unisem 利润表（单位百万元）	8
图表 12：并购后营收以及利润变化	8
图表 13：2017 主流封测厂营收排名以及增长	9
图表 14：本周半导体走势排名（%）	10
图表 15：半导体板块涨幅前十	10
图表 16：半导体板块跌幅前十	10
图表 17：半导体行业公司限售股份解禁日期及比例	12
图表 18：半导体产业重点公司估值数据跟踪	12

一、行业观察

【事件一】华为首款 7nm 芯片将为下半年手机销量注入强心剂

2018 年 8 月 31 日，华为在德国柏林 IFA 展会上发布了最新一代 AI 芯片--麒麟 980 (Kirin 980)。这款芯片采用了业界最先进的 7nm 制程工艺，与采用 10nm 工艺的芯片相比，处理器性能提升 20%，芯片功耗降低约 40%，晶体管密度也提高了 1.6 倍，高达 69 亿个。

图表 1：麒麟 980 芯片提升方面汇总



来源：华为发布会 PPT，国金证券研究所

【点评】

- **7nm 麒麟 980 奏响安卓世界的中国最强音。**从 2004 年任正非决定华为要做自己的手机芯片开始，由华为集成电路设计中心改制而成的海思半导体就扛起了中国手机芯片的大旗。2009 年海思发布了第一款智能手机芯片 k3v1，不过由于当时产品设计还不成熟所以并未推向市场。之后经过 10 年的磨砺和改进，终于在 2014 年以“麒麟”+“数字”命名的系列芯片迎来了爆发期。伴随着荣耀 6 一起发布的麒麟 920 芯片第一次真正惊艳了整个手机产业，这是当时全球首款集成音频芯片、视频芯片、ISP 的 LTE CAT.6 芯片，后续的麒麟 950，麒麟 960 和麒麟 970 不断蜕变和升级，性能越来越强，功耗逐年下降，不断刷新着华为手机的口碑和销量。最新发布的这款麒麟 980 芯片采用了台积电最先进的 7nm 工艺，性能提升 20%，功耗大幅下降 40%，让海思麒麟芯片再一次成为了安卓世界的最强者。虽然从跑分结果来看，芯片性能距离苹果即将发布的 A12 和高通还在酝酿中的骁龙 855 还有一定差距，但是从数据上来看和全球手机 SOC 龙头高通的差距已经不大，说明海思半导体经过多年追赶之后从技术上已经跻身世界前列。

图表 2：海思麒麟系列芯片“进化”之路

华为海思芯片系列	麒麟920	麒麟950	麒麟960	麒麟970	麒麟980
发布时间	2014	2015	2016	2017	2018
首发机型	荣耀6	Mate 8	Mate 9	Mate 10	Mate 20
采取工艺	28nm	16nm	16nm	10nm	7nm
单核跑分	859	1909	1941	2016	3360
相比上一代提升		122%	2%	4%	67%
多核跑分	3211	6096	5996	6540	-
相比上一代提升		90%	-2%	9%	-
性能较上一代提升	15%	11%	15%	20%	20%
功耗较上一代下降	15%-30%	20%	40%	50%	40%

来源：网络公开资料整理，国金证券研究所

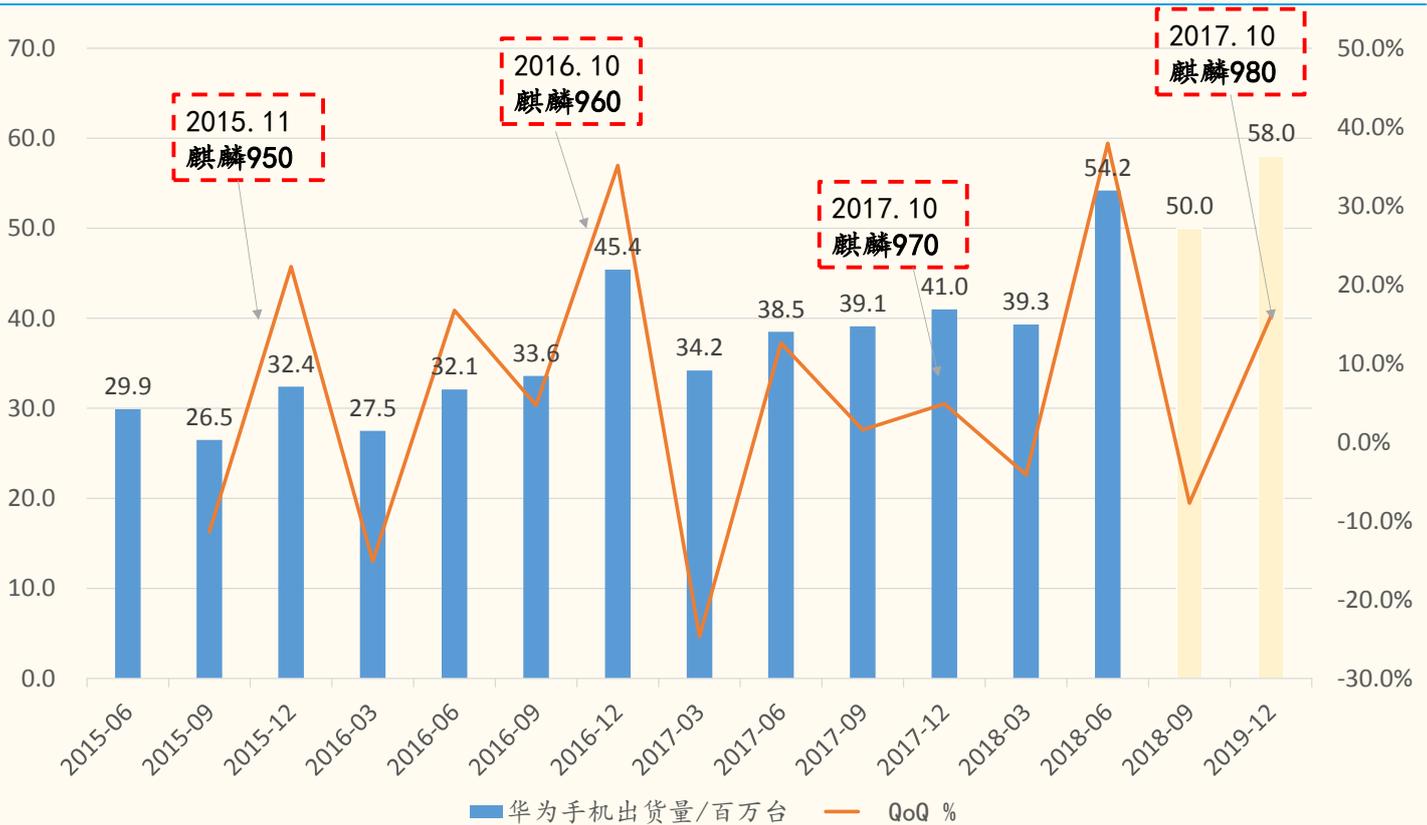
图表 3：华为海思，苹果和高通 7nm 手机芯片对比

全球龙头厂商 7nm 手机芯片	苹果 A12	高通骁龙 855	华为麒麟 980
单核跑分	4673	3697	3360
相比上一代提升	10%	54%	67%
多核跑分	10912	10469	-
相比上一代提升	7%	20%	-
性能较上一代提升	20%-25%	-	20%
体积较上一代减少	40%	-	40%
功耗较上一代下降	40%	-	40%

来源：网络公开资料整理，国金证券研究所

- **芯片强，则手机强。**根据 IDC 最新报告显示，华为第二季度出货量为 5420 万部，季度出货量首次超越苹果的 4130 万部，位列全球第二，市场份额达到 15.8%，相比去年同期大幅增长 40.9%。从目前全球智能手机厂商市占率来看，自身具有手机芯片设计能力的三星，华为和苹果稳坐行业前三，说明了具备手机 SoC 研发实力已经成为手机企业最重要的核心竞争力之一。海思自研的麒麟芯片取得巨大成功以后，不断推动华为旗下手机品牌市占率提升。从下图可以看出，近几年几乎每一次麒麟芯片的发布都伴随着手机出货量的大幅增长。此次推出的新一代麒麟 980AI 芯片预计将搭载 10 月 16 日发布的 mate20 和 mate 20 PRO 等旗舰机型首发，这两款手机也将成为安卓世界搭载 7nm 芯片的唯一旗舰机型。原因在于台积电今年下半年的产能几乎被苹果和华为垄断，所以其他安卓手机搭载的高通骁龙和联发科 7nm 芯片的机型最早也要在明年一季度才会推出，而三星由于 7nm 制程的良率瓶颈一直没有突破，也很难加入 2018 年下半年的 7nm 智能手机之争。因此麒麟 980 的提前量产有望为 mate20 系列新机带来领先于其他安卓手机大约 3-6 个月的黄金销售时间，极大的带动华为手机出货量。

图表 4: 2015-2019E 华为手机出货量及麒麟芯片发布时间对比



来源: IDC, 旭日大数据, 国金证券研究所

- 站在华为背后的供应链将深度受益。在安卓手机领域，最先推出 7nm 芯片的华为手机有望在今年下半年迎来新的出货量增长高峰期，华为手机的供应链企业将深度受益。目前华为在全球的供应商已经超过 2000 家，其中有 26 家顶级半导体公司。预计在 10 月 12 日发布的 Mate20 和 Mate20 Pro 搭载的麒麟 980 是由全球最大的晶圆厂台积电代工生产的，而芯片的封装测试则交给日月光/矽品位于苏州的工厂完成。华为手机的整机代工还是由富士康负责生产，瑞声科技提供声学元件如扬声器和听筒等产品，生益科技是华为高端 PCB 主力供应商。而且根据产业链的调研信息，华为 mate 20 Pro 旗舰手机很可能采用高通提供的第二代超声波屏下指纹解决方案，而手机 OLED 屏幕则由京东方供应部分，数量至少在 100 万块。而安卓手机的其他前几大厂商如小米、OPPO 和 VIVO 由于采用高通 7nm 芯片的手机至少要等到明年一季度才有望推出，所以这些手机品牌的供应链厂商由于新机亮点缺乏换机出货动力不强导致业绩可能承压。

■ 投资建议

中国大陆/台湾重点关注：台积电，小米，华为

全球重点关注：高通，三星

■ 风险提示

目前消费需求乏力，手机换机动力不足，华为手机出货量不及预期

苹果先于华为推出采用 7nm 工艺的新款机型，对于华为旗舰机型销售造成冲击。

【事件二】长电科技：封测龙头备战 5G 通讯和物联网

长电科技历时长达一年的定增预案终于落下帷幕，2018 年 9 月 1 日公司宣布向国家产业基金，芯电半导体和金投领航 3 名特定投资者增发约 2.4 亿股普通股，发行价格为 14.89 元/股，募集资金总额约为 36 亿元。其中产业基金出资 26 亿元，持股比例从发行前的 9.54% 上升至 19%，跃居为公司第一大股东，中芯国际子公司芯电半导体从原来的第一大股东退居次席，发行完成后持股比例仍为 14.28%，无锡金投领航成为公司第四大股东，持股 2.09%。最初也在定增对象之列的兴银投资、中江长电先后推出此次非公开发行，募资总额与去年 9 月公布的定增金额不超过 45.5 亿的上限也有一定差距。

图表 5：公司前五大股东定增前后的持股比例变化

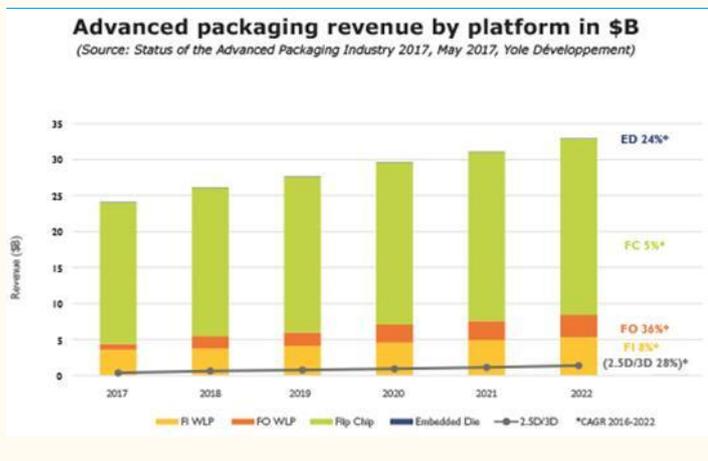
名次	股东名称	持股数 (百万股)	持股比例	限售股份占比	发行后持股比例变动	发行后股东名次变动	股东背景
1	国家集成电路基金	304	19.00%	100%	9.46%	2	国家基金
2	芯电半导体	229	14.28%	100%	0.00%	-1	中芯国际子公司
3	江苏新潮科技	167	10.42%	31%	-2.61%	-1	
4	无锡金投领航	34	2.09%	100%	2.09%	新进	
5	香港中央结算	32	2.09%	0%	-0.28%	-1	

来源：wind，国金证券研究所

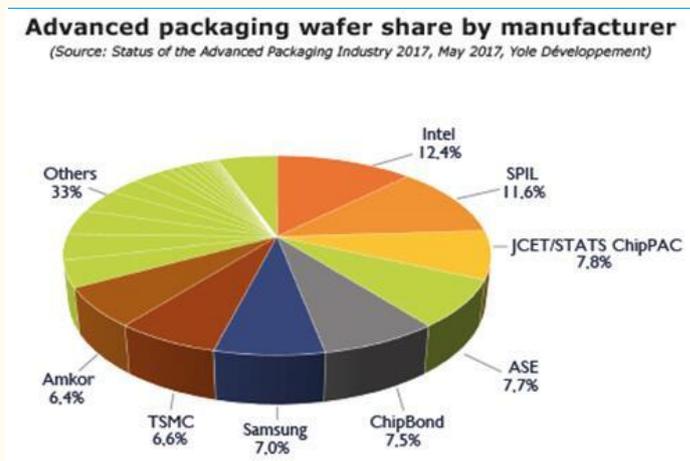
【点评】

- 先进封装发展趋势确定，长电科技大幅扩产。按照摩尔定律发展的半导体行业更新速度正在减慢，由于动辄数十亿美元高额资本支出费用让很多晶圆代工厂退出了先进制程的竞争，但是市场对于芯片算力提升的需求依然存在，先进封装工艺的提升成为了“后摩尔定律”时代有效提升芯片性能的解决方案之一。据市场咨询机构 Yole Développement 估计，2016~2022 年期间，先进封装产业总体营收的复合年增长率 (CAGR) 预计可达 7%，超过了总体封装产业 (3~4%)、半导体产业 (4~5%)、PCB 产业 (2~3%)、全球电子产业 (3~4%) 以及全球 GDP (2~3%)。就具体封装技术平台而言，Fan-out (扇外型) 增速最快，达到了 36%，紧随其后的是 2.5D/3D TSV 平台，增长速度为 28%。收购新加坡星科金朋之后的长电科技在先进封装工艺和产能方面实现了快速的提升，2017 年先进封装产品出货量排名第三位，这次公司发布定增融资的原因之一就是要进一步扩充公司在先进封装方面的产能。其中之一通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目建成后公司建成后将形成 Bumping、WLCSP 等通讯与物联网集成电路中道封装年产 82 万片 Bumping、47 亿颗芯片封装的生产能力。

图表 6：不同先进封装技术平台营收占比 (十亿美元)



图表 7：2017 年先进封装市场各企业出货量占比

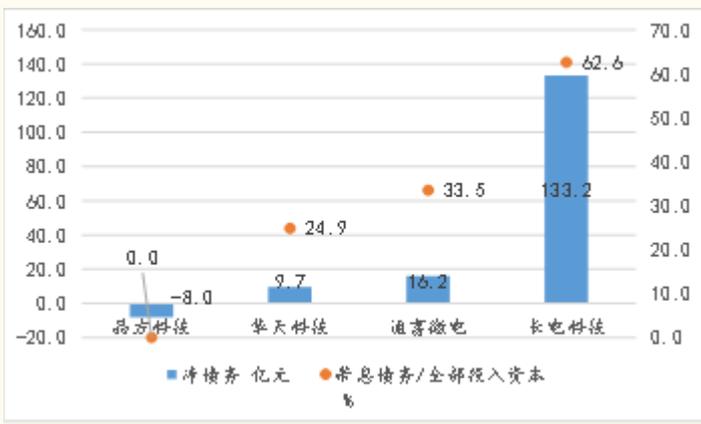


来源：Yole Development, 国金证券研究所

来源：Yole Development, 国金证券研究所

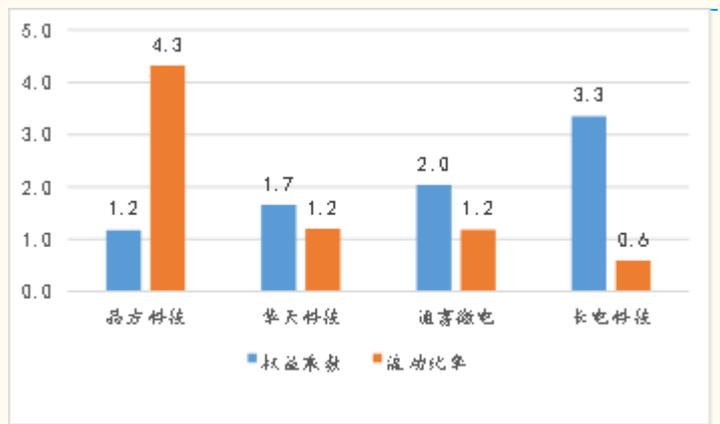
- **剑指 5G 通讯和物联网市场，加码通信用高密度封装工艺。**科技行业未来 5 年最确定的投资机遇当属 5G 通讯的商用化和人工智能驱动的物联网落地。5G 时代数据的传输速度比 4G 时代快 10 倍以上，对于通讯芯片的处理速率要求也更高。以 400G 网络处理芯片为例，虽然芯片制造工艺从 28nm 迈入到 14nm 时代各类规格指标有所改善，但是仅凭芯片制造工艺上的进步已不能解决 400G NP 面临的高带宽问题。而高密度集成封装技术和晶圆级封装工艺 TSV 的进步能够在兼顾成本的基础上进一步提升通讯芯片的性能，因此长电科技募集资金之后会加大 FBGA、PBGA、SIP 模组、P-SIP 模组、通讯模块-LGA、高脚位通讯模块、倒装通讯模块等通信用高密度集成电路及模块封装技术的投入，新项目建成之后年产能将达到 20 亿块。而在万物互联时代对于各类芯片的要求是“体积更小，功耗更低”，先进的封装工艺如 Fan-out eWLB、WLCSP、SiP、BUMP、PoP 使得芯片做的更小，更薄，所以公司此时的扩产是在为物联网的爆发提前布局。
- **杠杆率持续高位，缓解债务压力。**公司募集资金除了为 5G 通讯市场和物联网市场的发展进行提前布局之外，也是为了缓解公司负担沉重的财务压力。2015 年并购新加坡封测厂商星科金朋之后长电科技进入了漫长的整合时期，财务杠杆处于高位，而且为了抓住半导体行业的发展机遇，公司需要增加生产线和扩大产能，公司负债率进一步提升。截止 2018 年上半年，公司的净债务高达 133 亿元左右，远超同行也水平，而且公司的带息债务率也是超过国内第二和第三的封测厂商一倍左右。从流动比率来看，长电科技也是行业内唯一一家低于 1 以内的，说明短期内公司有债务偿付危机，也表明公司需要进行定增的迫切性，而且权益乘数约为 3.3 倍，高企的财务杠杆给企业带来巨大的经营压力，这次定增完成之后公司的流动资金得以补充，短期经营危机和资金链断裂的风险初步消除。

图表 8：1H18 国内封测企业净债务和带息负债率对比



来源：wind, 国金证券研究所

图表 9：1H18 国内封测企业权益乘数和流动比率对比



来源 wind, 国金证券研究所

- **投资建议：**
建议关注长电科技

- **风险提示：**
半导体行业景气度下降，对于封测行业营收造成不利影响。
公司产品以出口为主，美元兑人民币汇率可能对公司营收造成较大波动。
中美贸易战对于半导体封测行业的影响较大，后续贸易战带来的关税影响仍具有不确定性因素。

【事件三】华天科技拟与控股股东收购马来西亚封装厂 Unisem75%股份

华天科技与控股股东华天电子集团拟以自愿全面要约方式联合收购 Unisem 公司除马来西亚联合要约人 (“John Chia”、“Alexander Chia”、“Jayvest Holdings”、“SCQ Industries”) 直接持有 Unisem 公司股份以外的股份 75.72%。收购对价 29.9 亿元。华天科技持有 Unisem 公司流通股股权不超过 60%。

【点评】

- 标的的基本情况：Unisem 公司成立于 1989 年 6 月 19 日，目前在马来西亚证券交易所主板上市，股票代码 5005.KL，现拥有员工约 7900 人，主要从事半导体封装和测试业务，拥有 bumping、SiP、FC、MEMS 等封装技术和能力。Unisem 公司在马来西亚霹靂州怡保、中国成都、印度尼西亚巴淡设有三个封装基地。

图表 10: unisem 资产负债表 (单位百万元)

单位: 百万元	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31
存款和其他现金及现金等价	479.41	574.08	417.87
应收账款	304.18	286.06	337.39
存货	285.08	267.85	229.54
物业、厂房及设备	1793.54	1809.76	1858.88
其他资产	75.18	100.20	97.28
资产总额	2937.38	3037.94	2940.96
应付账款	390.75	147.25	153.92
长期借款	11.76	14.73	25.50
短期借款	59.95	59.23	59.49
其他负债	93.69	408.28	365.62
负债总额	556.14	629.50	604.53
所有者权益	2381.24	2408.44	2336.43
归属于母公司所有者权益	2368.89	2396.43	2327.61

来源：公司公告，国金证券研究所

图表 11: Unisem 利润表 (单位百万元)

项目	2018年1-6月	2017年	2016年
营业收入	1094.53	2413.35	2177.99
净利润	61.58	265.76	268.95
归属于母公司所有者净利润	61.24	262.56	267.21

来源：公司公告，国金证券研究所

■ 对上市公司的影响

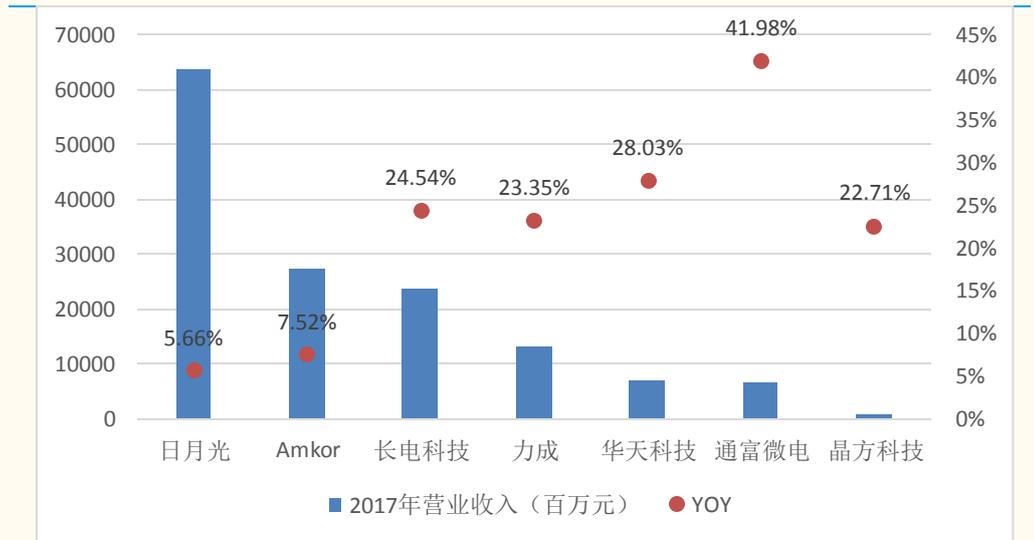
- 1) 扩大下游客户属性与应用范围，增加先进封装能力。Unisem 公司主要客户，包括 Broadcom、Qorvo、Skyworks 等公司。公司若交易完成后，可以增加对通信射频器件封装能力，填补在高端产品客户空白。在 5G 即将到来的关键时间点，公司有望直接受益。
- 2) 营收有望破百亿，稳居世界前五大封装厂。目前中国公司在半导体产业链中，封测领域自主率最高，世界前十大封测厂中国已占 3 席。若本次交易完成后，华天科技营收有望破百亿，成为第二个营收超过 100 亿的中国封测公司。假设交易按公告完成，公司持有 60% 标的流通股，合并报表后，预计公司营收与归母净利润均有 30% 以上增长。
- 3) 减少中美贸易战关税影响。被收购标的注册于马来西亚，鉴于目前中美贸易战愈演愈烈，公司通过控股国外公司的行为，可以缓解中美贸易战增加关税对于公司产品的影响。

图表 12: 并购后营收以及利润变化

2017年数据 (单位: 百万元)				
项目	华天科技	UNISEM	华天科技+UNISEM	变化
营业收入	7009.89	2413.35	9423.24	34.43%
归属于母公司所有者净利润	495.17	262.56	652.70	31.81%

来源：wind 国金证券研究所

图表 13: 2017 主流封测厂营收排名以及增长



来源: wind, 国金证券研究所

■ 投资建议

建议关注华天科技

■ 风险提示

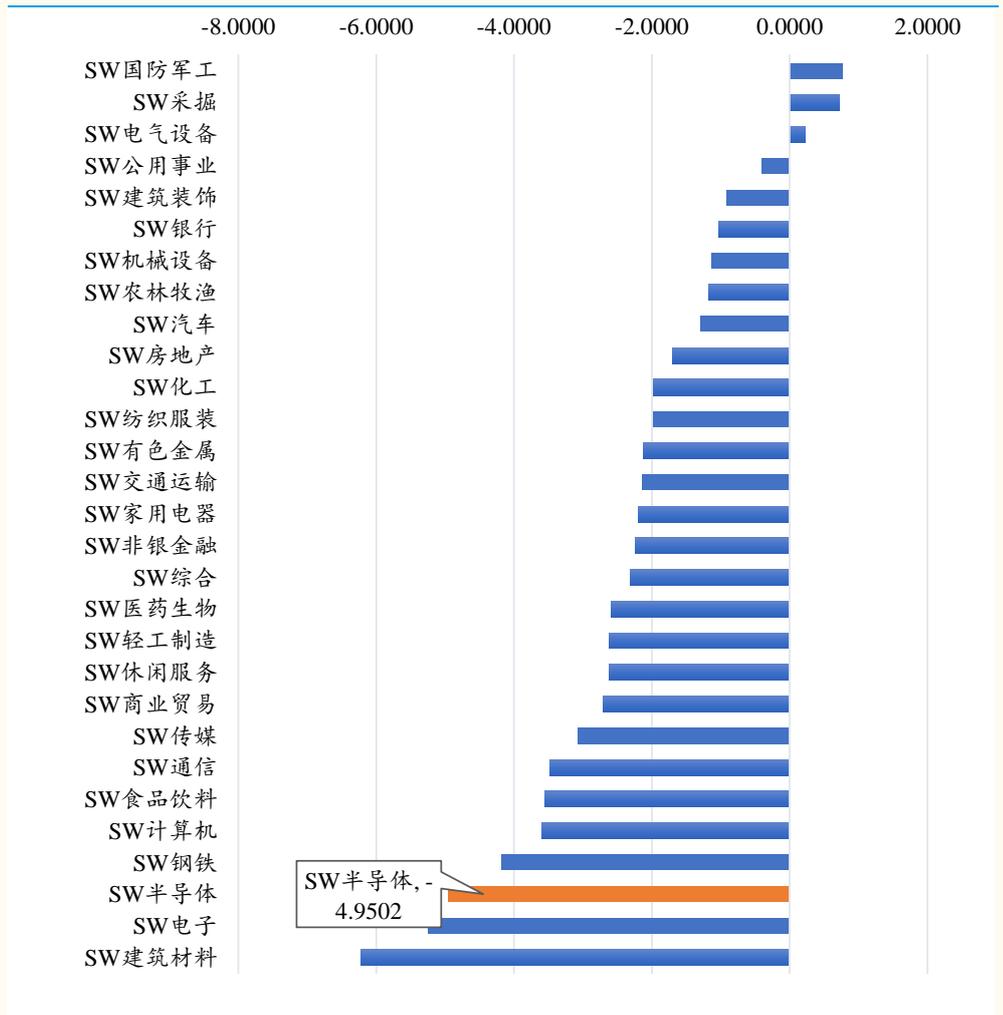
不确定性风险: 本次要约事项尚需公司股东大会、国内有权机构批准或备案以及马来西亚证券委员会对本次要约涉及的文件同意后方可发出, 且需 Unisem 公司股东接受要约。因此, 本次要约能否成功以及要约完成时间存在不确定性。

经营风险: 本次要约后, Unisem 公司能否继续保持稳定经营, 且公司需要承担因融资所必要的财务费用, 增加了后续经营风险。

二、行情回顾

- 截止本周三收盘, 最近 5 个交易日 A 股下跌 2.02%, 沪深 300 下跌 2.19%, 电子板块下跌 5.24%, 半导体板块下跌 4.95%。
- 涨跌幅榜分别为: 韦尔股份+21.00%, 东软载波+0.66%, 华微电子-0.66%, 康强电子-1.31%, 华天科技-1.58%; 兆易创新-18.02%, 北方华创-17.82%, 长电科技-14.97%, 圣邦股份-12.93%, 士兰微-12.53%

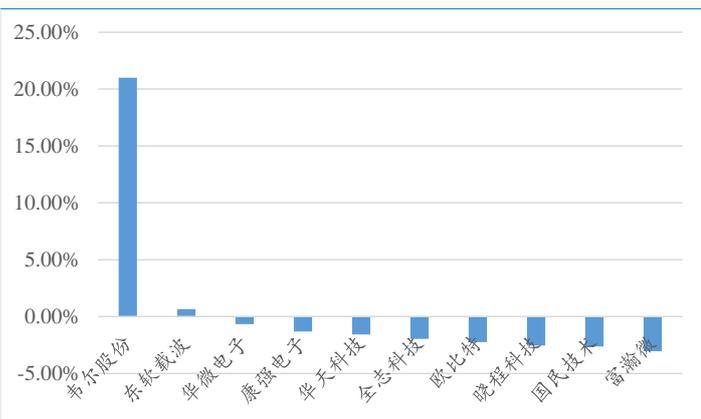
图表 14：本周半导体走势排名 (%)



来源：wind，国金证券研究所

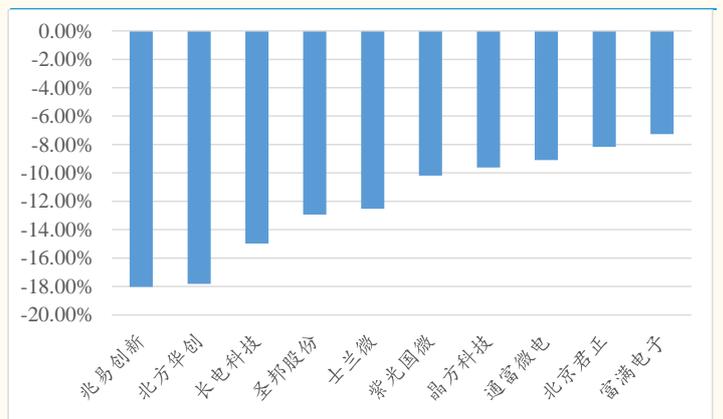
■ 本周半导体板块涨跌幅排名

图表 15：半导体板块涨幅前十



来源：wind，国金证券研究所

图表 16：半导体板块跌幅前十



来源：wind，国金证券研究所

三、A股重要公告总结

【盈方微】立案调查进展暨风险提示公告

公司因相关行为涉嫌违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

【汇顶科技】2018 年股票期权激励计划

本激励计划拟授予股票期权 1000.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 45,691.0757 万股的 2.19%。其中首次授予 800.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 45,691.0757 万股的 1.75%；预留 200.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 45,691.0757 万股的 0.44%，预留部分占本次授予权益总额的 20%。

【韦尔股份】发行股份收购北京豪威科技公告

本次交易中，韦尔股份拟以发行股份的方式购买 27 名股东持有的北京豪威 96.08% 股权、8 名股东持有的思比科 42.27% 股权以及 9 名股东持有的视信源 79.93% 股权，同时拟采取询价的方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20 亿元，用于标的公司建设项目及支付中介机构费用。

【华天科技】关于与控股股东签订《关于 UNISEM(M)BERHAD 之联合要约合作协议》的公告

公司拟与控股股东天水华天电子集团股份有限公司及马来西亚主板上市公司 UNISEM (M) BERHAD（以下简称“Unisem 公司”）之股东以自愿全面要约方式联合收购 Unisem 公司股份。

【圣邦股份】关于特定股东股份减持计划的进展公告

持有本公司股份 2,389,973 股（权益分派之前的持股数，占本公司总股本比例 3.93%）的股东 HONOUR BASE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED（以下简称“香港荣基”）计划通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划公告之日 2018 年 9 月 12 日起的 6 个月内；通过集中竞价方式减持的，减持期间为减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。预计减持数量合计不超过 608,658 股，即不超过公司总股本的 1.00%

【长电科技】股东减持股份计划公告

江苏新潮科技集团有限公司（下称“新潮集团”）持有本公司 167,078,984 股，占本公司总股本的 10.42%。自 2018 年 9 月 13 日起 15 个交易日后的 90 日内，新潮集团计划以集中竞价交易方式减持不超过 1,600 万股，占公司总股本的 1.00%。

四、半导体行业公司限售股份解禁情况

图表 17: 半导体行业公司限售股份解禁日期及比例

证券代码	证券简称	解禁股份性质	限售解禁日期	总股本亿股	本期解禁数量亿股	解禁占比
600198.SH	*ST大唐	定向增发机构配售股份	2019-05-13	8.82	0.05	0.58%
603005.SH	晶方科技	首发原股东限售股份	2019-04-18	2.33	0.03	1.29%
300474.SZ	景嘉微	首发一般股份, 首发机构配	2019-04-01	2.71	2.00	73.85%
601908.SH	京运通	定向增发机构配售股份	2019-03-22	19.95	0.01	0.06%
002156.SZ	通富微电	定向增发机构配售股份	2019-01-23	11.54	1.81	15.70%
300373.SZ	扬杰科技	股权激励限售股份	2019-01-23	4.72	2.34	49.55%
600460.SH	士兰微	定向增发机构配售股份	2019-01-14	13.12	0.65	4.95%
002180.SZ	纳思达	股权激励限售股份	2018-12-24	10.64	0.52	4.86%
600584.SH	长电科技	定向增发机构配售股份	2018-11-26	13.60	0.51	3.78%
300604.SZ	长川科技	首发原股东限售股份	2018-06-25	1.48	0.14	9.16%
603986.SH	兆易创新	首发原股东限售股份	2018-06-21	2.84	0.01	0.39%

来源: wind, 国金证券研究所

五、半导体产业重点公司估值数据跟踪

图表 18: 半导体产业重点公司估值数据跟踪

产业	新应用	证券代码	证券简称	人民币 价格	发行总股本 亿股	人民币 市值 亿元	美金 市值 亿美元	2019E 每股收益	2020E 每股收益	2019E 市盈率	2020E 市盈率	2019E 市销率	2020E 市销率
系统行业	平均									15.10	11.43	1.91	1.51
系统	安防	002415.SZ	海康威视	26.69	92.27	2,462.76	385.03	1.61	2.03	16.60	13.12	3.59	2.81
系统	安防	002236.SZ	大华股份	14.02	28.99	406.41	63.54	1.29	1.70	10.87	8.26	1.24	0.93
系统	打印机, IC	002180.SZ	纳思达	24.42	10.64	259.73	40.61	1.37	1.89	17.82	12.92	0.91	0.78
制造行业	平均									25.30	20.42	4.31	3.49
半导体 IDM	功率, LED	600703.SH	三安光电	15.11	40.78	616.25	96.35	1.23	1.57	12.24	9.61	4.38	3.37
半导体 IDM	功率, MEMS	600460.SH	士兰微	9.94	13.12	130.42	20.39	0.24	0.30	41.30	33.05	3.10	2.55
半导体 IDM	功率	600360.SH	华微电子	5.94	7.52	44.64	6.98	0.26	0.33	22.86	17.97	1.74	1.38
半导体 IDM	功率, 电力	300623.SZ	捷捷微电	30.93	1.80	55.59	8.69	1.25	1.47	24.81	21.04	8.01	6.68
封测行业	平均									18.03	13.76	1.44	1.12
半导体封测	逻辑	600584.SH	长电科技	14.20	16.03	227.61	35.58	0.72	1.00	19.77	14.13	0.68	0.57
半导体封测	DRAM	600667.SH	太极实业	6.15	21.06	129.53	20.25	0.37	0.45	16.83	13.70	0.71	0.58
半导体封测	逻辑	002185.SZ	华天科技	4.87	21.31	103.79	16.23	0.36	0.44	13.80	11.20	0.98	0.80
半导体封测	逻辑	002156.SZ	通富微电	9.19	11.54	106.03	16.58	0.50	0.65	18.20	14.14	1.02	0.86
半导体封测	逻辑	603005.SH	晶方科技	17.63	2.34	41.29	6.46	0.82	1.13	21.57	15.61	3.84	2.79
设计行业	平均									36.17	27.84	7.82	5.99
半导体设计	3D感测, 指纹, 触控	603160.SH	汇顶科技	80.61	4.57	368.32	57.58	2.65	3.19	30.39	25.25	7.05	
半导体设计	功率	300373.SZ	扬杰科技	21.80	4.72	102.95	16.10	0.99	1.27	22.04	17.22	4.02	3.11
半导体设计	功率, 电源	603501.SH	韦尔股份	41.43	4.56	188.84	29.52	1.12	1.41	36.90	29.31	2.75	2.27
半导体设计	存储, 记忆体	603986.SH	兆易创新	93.30	2.85	265.57	41.52	3.14	4.57	29.69	20.43	6.21	4.36
半导体设计	军用	300474.SZ	景嘉微	50.46	2.71	136.65	21.36	0.72	0.95	70.52	53.02	27.10	20.28
半导体设计	安防	300613.SZ	富瀚微	113.92	0.45	51.62	8.07	4.32	5.58	26.40	20.40	6.27	4.82
半导体设计	安防, 导航	300053.SZ	欧比特	10.37	7.02	72.81	11.38	0.36	0.49	28.50	21.32	5.23	4.10
半导体设计	显示屏驱动IC	300327.SZ	中颖电子	21.65	2.31	50.01	7.82	1.03	1.46	20.96	14.48	4.06	2.94
半导体设计	存储	002049.SZ	紫光国微	37.93	6.07	230.17	35.98	0.80	0.96	47.60	39.38	6.94	5.37
半导体设计	电源管理, 模拟芯片	300661.SZ	圣邦股份	92.86	0.79	73.74	11.53	1.91	2.47	48.74	37.56	8.57	6.68
设备行业	平均									50.47	36.48	7.71	5.65
半导体设备与材料	半导体装备	002371.SZ	北方华创	48.08	4.58	220.21	34.43	0.83	1.23	58.07	39.06	4.50	3.23
半导体设备与材料	封测	300604.SZ	长川科技	41.63	1.48	61.72	9.65	0.82	1.18	50.82	35.13	14.02	9.80
半导体设备与材料	高纯溅射靶材	300666.SZ	江丰电子	44.06	2.19	96.39	15.07	0.56	0.72	79.39	60.97	9.72	7.46
半导体设备与材料	集成电路抛光垫	300054.SZ	鼎龙股份	7.23	9.61	69.48	10.86	0.53	0.67	13.58	10.75	2.62	2.10
A股半导体产业	平均									30.78	23.42	5.36	4.02
产业	新应用	证券代码	证券简称	港币 价格	发行总股本 亿股	港币 市值 亿港元	美金 市值 亿美元	2019E 每股收益	2020E 每股收益	2019E 市盈率	2020E 市盈率	2019E 市销率	2020E 市销率
光学模组	车用相机	2382.HK	舜宇光学	87.75	10.97	962.62	122.69	4.76	6.25	16.10	12.26	2.51	2.04
IDM, system	功率器件	3898.HK	中车电气	40.15	11.75	471.95	60.15	2.82	3.15	12.41	11.13	2.48	2.20
半导体晶圆代工		0981.HK	中芯国际	8.35	50.52	421.82	53.76	0.03	0.06	31.29	17.91	10.67	8.67
半导体晶圆代工		1347.HK	华虹半导体	15.30	10.41	159.25	20.30	0.19	0.21	10.35	9.35	15.26	12.99
港股半导体产业	平均									17.54	12.66	7.73	6.47

产业	新应用	证券代码	证券简称	2019E	2020E	2019E	2020E	未来2年营收复合增长率 (%)	毛利率 (%)	营业利润率 (%)	净现金/权益 (%)
				市净率	市净率	净资产收益率	净资产收益率				
系统行业	平均			3.83	2.99	25.55	26.32				
系统	安防	002415.SZ	海康威视	4.99	3.89	30.58	30.21	27.95	44.50	22.54	11.77
系统	安防	002236.SZ	大华股份	2.48	1.94	23.51	24.09	31.67	36.52	12.75	-30.24
系统	打印机, IC	002180.SZ	纳思达	4.02	3.14	22.57	24.64	15.75	37.94	1.77	-144.48
制造行业	平均			2.96	2.70	12.96	14.11	26.42	36.41	24.75	10.52
半导体 IDM	功率, LED	600703.SH	三安光电	2.32	1.92	19.14	20.35	29.50	48.88	49.18	21.22
半导体 IDM	功率, MEMS	600460.SH	士兰微	4.11	3.83	10.28	11.40	23.85	26.69	4.29	-15.78
半导体 IDM	功率	600360.SH	华微电子	1.89	1.77	8.34	9.85	25.39	20.97	6.95	1.91
半导体 IDM	功率, 电力	300623.SZ	捷捷微电	3.53	3.25	14.09	14.83	26.94	49.10	38.58	34.71
封测行业	平均			1.81	1.64	10.21	12.05	24.29	17.17	4.84	-28.38
半导体封测	逻辑	600584.SH	长电科技	2.21	2.00	11.56	14.78	18.80	12.37	0.53	-135.93
半导体封测	DRAM	600667.SH	太极实业	1.80	1.63	10.47	11.63	23.56	11.39	3.74	-18.19
半导体封测	逻辑	002185.SZ	华天科技	1.54	1.38	11.54	12.72	22.20	16.34	7.32	-10.35
半导体封测	逻辑	002156.SZ	通富微电	1.54	1.42	8.48	9.73	26.10	17.07	2.94	-22.00
半导体封测	逻辑	603005.SH	晶方科技	1.97	1.76	9.01	11.36	30.78	28.68	9.67	44.57
设计行业	平均			6.23	5.17	18.13	19.25	36.47	41.59	18.07	24.28
半导体设计	3D感测, 指纹, 触控	603160.SH	汇顶科技	7.52	6.02	22.71	22.11	19.10	39.65	6.17	33.75
半导体设计	功率	300373.SZ	扬杰科技	3.42	2.93	15.79	17.29	31.99	33.15	21.37	-10.28
半导体设计	功率, 电源	603501.SH	韦尔股份	10.40	8.54	23.02	22.28	71.02	28.13	9.53	-7.06
半导体设计	存储, 记忆体	603986.SH	兆易创新	8.93	6.37	32.60	32.87	45.14	37.87	22.43	19.55
半导体设计	军用	300474.SZ	景嘉微	8.50	7.55	12.61	14.67	28.31	78.69	33.67	27.85
半导体设计	安防	300613.SZ	富瀚微	4.01	3.38	15.22	16.26	35.37	42.31	17.44	47.92
半导体设计	安防, 导航	300053.SZ	欧比特	2.88	2.61	10.70	12.50	37.28	41.13	18.45	34.58
半导体设计	显示屏驱动IC	300327.SZ	中颖电子	4.68	3.72	22.41	25.35	34.62	42.68	22.41	37.69
半导体设计	存储	002049.SZ	紫光国微	5.51	4.95	11.97	12.83	34.63	27.04	12.62	8.98
半导体设计	电源管理, 模拟芯片	300661.SZ	圣邦股份	6.41	5.64	14.31	16.35	27.20	45.28	16.58	49.83
设备行业	平均										
半导体设备与材料		002371.SZ	北方华创	5.53	4.84	10.23	13.25	48.43	38.67	11.94	-14.66
半导体设备与材料	封测	300604.SZ	长川科技	9.57	7.60	19.39	22.15	56.47	61.47	23.86	48.31
半导体设备与材料	高纯溅射靶材	300666.SZ	江丰电子	12.69	10.61	15.80	16.98	34.30	28.73	9.12	-6.29
半导体设备与材料	集成电路抛光垫	300054.SZ	鼎龙股份	1.61	1.47	11.92	13.57	24.81	36.04	21.32	19.08
A股半导体产业	平均			4.77	4.01	16.09	17.46	31.97	35.82	15.66	1.02

产业	新应用	证券代码	证券简称	2019E	2020E	2019E	2020E	2019E 营收增速 %	毛利率 (%)	营业利润率 (%)	净现金/权益 (%)
				市净率	市净率	净资产收益率	净资产收益率				
光学模组	车用相机	2382.HK	舜宇光学	5.62	4.26	39.57	38.88	30.61	19.37	12.65	-1.62
IDM, system	功率器件	3898.HK	中车电气	1.91	1.65	15.39	14.65	15.53	38.01	17.06	18.77
半导体晶圆代工		0981.HK	中芯国际	0.95	0.94	3.36	4.24	14.87	25.44	3.38	-28.18
半导体晶圆代工		1347.HK	华虹半导体	0.95	0.91	9.35	9.56	12.88	32.87	19.14	16.64
港股半导体产业	平均			2.36	1.94	16.92	16.83	18.47	28.92	13.06	1.40

来源: wind, 国金证券研究所

公司投资评级的说明:

- 买入: 预期未来 6—12 个月内上涨幅度在 15%以上;
- 增持: 预期未来 6—12 个月内上涨幅度在 5%—15%;
- 中性: 预期未来 6—12 个月内变动幅度在 -5%—5%;
- 减持: 预期未来 6—12 个月内下跌幅度在 5%以上。

行业投资评级的说明:

- 买入: 预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上;
- 增持: 预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%;
- 中性: 预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%;
- 减持: 预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。

特别声明:

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，对由于该等问题产生的一切责任，国金证券不作出任何担保。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整。

本报告中的信息、意见等均仅供参考，不作为或被视为出售及购买证券或其他投资标的邀请或要约。客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；非国金证券 C3 级以上（含 C3 级）的投资者擅自使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

此报告仅限于中国大陆使用。

上海

电话：021-60753903

传真：021-61038200

邮箱：researchsh@gjzq.com.cn

邮编：201204

地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 7 楼

北京

电话：010-66216979

传真：010-66216793

邮箱：researchbj@gjzq.com.cn

邮编：100053

地址：中国北京西城区长椿街 3 号 4 层

深圳

电话：0755-83831378

传真：0755-83830558

邮箱：researchsz@gjzq.com.cn

邮编：518000

地址：中国深圳福田区深南大道 4001 号

时代金融中心 7GH